課題番号 : F-18-FA-0025 利用形態 : 機器利用(FAIS)

利用課題名(日本語) :MEMS 技術を用いた機能性表面の創製

Program Title (English) : Fabrication of functional surfaces based on MEMS

利用者名(日本語) :長山暁子1), 板花佑紀2), 三苫凌哉2)

Username (English) : <u>G. Nagayama</u>¹⁾, Y. Itahana²⁾, R. Mitoma²⁾

所属名(日本語) :1) 九州工業大学工学研究院機械知能工学研究系,2) 九州工業大学大学院工学府機

械知能工学専攻

Affiliation (English) :1) Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu

Institute of Technology, 2) Department of Mechanical Engineering, Graduate

School of Engineering, Kyushu Institute of Technology

キーワード/Keyword :機能性表面、濡れ性、マイクロチャンネル、微細加工、成膜・膜堆積

1. 概要(Summary)

高い熱・物質輸送能力を持つ機能性表面を実現するため、北九州産業学術推進機構 FAIS 共同研究開発センターおよび山口大学 大学研究推進機構産学公連携センターの共用設備を利用して微細加工を行った.

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】 北九州産業学術推進機構 FAIS 共同研究開発センター:ケミカルプロセス装置群(プラズマ CVD,スパッタ装置,超純水製造装置),リソグラフィ装置群(スピンコーター,コータ/ディベロッパ,両面マスクアライナ,膜厚測定器),組立測定装置群(走査型電子顕微鏡,比抵抗測定器,ダイシングソー);山口大学 大学研究推進機構産学公連携センター:深掘りエッチング装置,電子顕微鏡

【実験方法】 P型シリコン試料に、北九州産業学術推進機構 FAIS 共同研究開発センターの電子ビーム描画装置、イオン注入装置、プラズマ CVD、露光装置、スパッタ装置ほかを用いて、パターニングとウェットエッチング等プロセ

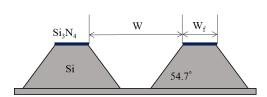


Fig. 1 Cross section of wet-etched substrate.

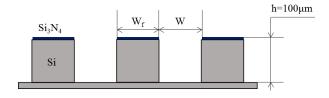


Fig. 2 Cross section of deep-etched substrate.

スによりマイクロオーダーの表面構造を形成した. 濡れ性強化処理として、プラズマ CVD により酸化膜(SiO₂)、窒化膜(Si₃N₄)を成膜する親水性処理を施した. また、山口大学大学研究推進機構産学公連携センターの深掘りエッチング装置を用いて、微細な表面構造を加工した.

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

ウェットエッチングで形成する構造断面をFig.1に示す.構造の断面形状が54.7°の台形となる.ウェットエッチングまで同じ工程で微細パターを形成した後,深掘りエッチングをした断面構造をFig.2に示す.構造の断面形状が90°の長方形になるように加工した.また,高いアスペクト比を実現するための深掘りエッチングの条件を検討した.

4. その他・特記事項(Others)

本研究の遂行にあたって、北九州市産業学術推進機構共同研究開発センターの竹内修三氏、および山口大学研究推進機構産学公連携センターの岸村由紀子氏から多大なる技術支援・研究協力を得た。また、科研費No.18H01385により助成を受けた。ここに記して感謝の意を表す。

他の機関の利用:山口大学(F-18-YA-0002)

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

- (1) Y. Itahana et al., Proc. 16th IHTC, (2018) pp.1-6.
- (2) R. Mitoma et al., Proc. 16^{th} IHTC, (2018) pp.1–6.

6. 関連特許(Patent)

なし